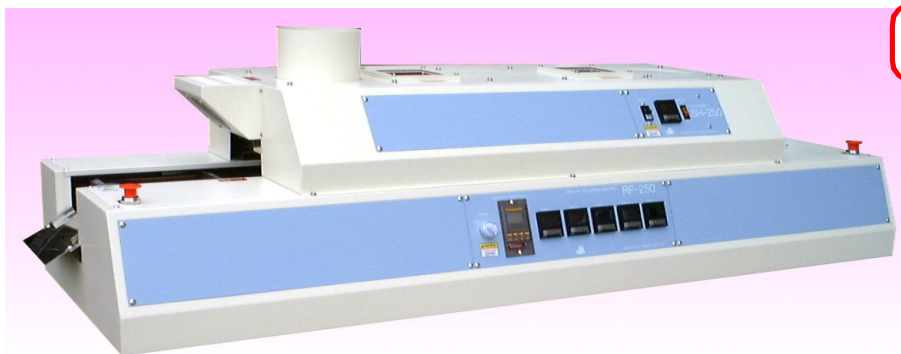




金属基板専用

金属基板専用リフローはんだ付け装置 RF-250

RF-250は熱容量の大きな、ホットプレート式リフローはんだ付け装置です。遠赤や熱風方式では難しい大きな熱容量を必要とするセラミックやホーロー基板、それに鉄やアルミなど金属基板のリフローはんだ付けができます。

基板はホットプレートの上を直接キャリアバーに押されて(又はテフロン・シートに引かれて)スライドします。基板を直にホットプレートから加熱するので、熱容量の大きな基板でも効率良く短時間に、高い温度精度でリフローはんだ付けできます。

特 長

- 5ゾーンの加熱プレートにより、熱容量の大きなホーロー基板や金属基板のリフローはんだ付けが容易にできます。
- 最大150×150×5mmのワーク基板までリフローはんだ付けできます。
- 加熱ゾーン全てがPIDデジタル温度制御なので、高精度で安定した温度プロファイルが得られます。
- 最高400℃まで加熱でき、300℃以上の高温はんだも使用できます。

仕 様

- ・加熱部 : 5ゾーン 幅150mm×長さ1000mm 入口高さ40mm
- ・プリヒート部
 - 第1ゾーン: (W)150×(L)200mm 1.1kW
 - 第2ゾーン: (W)150×(L)200mm 0.8kW
 - 第3ゾーン: (W)150×(L)200mm 0.8kW
- ・リフロー部 第4ゾーン: (W)150×(L)200mm 1.1kW+IR1.0kW
- ・アフターヒート部 第5ゾーン: (W)150×(L)200mm 0.8kW
- ・加熱方式 : ホットプレート方式(第4ゾーンのみ上部IRヒーター併用)
- ・温度制御 : Max400℃ P.I.D.温度調節器
- ・コンベア : キャリアバー(基板後押し金具)方式(間隔:200mm)
又はテフロン・シート・キャリア方式(146×150mm)
50~1000mm/min デジタル式スピード調節器
コンベア方向: 右→左 又は 左→右(指定)
- ・センサー : 熱電対K(CA)(ホットプレート内)
- ・冷 却 : 出口側ファンによる強制空冷
- ・電 源 : 単相200V 約6kW(220V/240V仕様も可) 50/60Hz
- ・安全装置 : 漏電/過電流ブレーカー。非常停止スイッチ。
警報出力(過温/低温)
- ・外形寸法 : (W)1680×(D)550×(H)391mm
- ・重 量 : 約120kg

適合基板

セラミック基板、ホーロー基板、金属基板、多層プリント回路基板。その他熱容量の大きな片面実装SMT基板。
寸法 : 25×25mm~150×150mm
板厚 : 0.8~5mm
高さ : Max40mm

用 途

- ・ホーロー基板や金属基板のリフローはんだ付け。
- ・放熱器、金属ブロックヘッチャ部品のはんだ付け。
- ・300℃以上の高温はんだ付け。
- ・その他熱容量の大きなワークへの加熱作業。

短 所

- ・片面実装基板のみ使用可能です。
- ・加熱すると反りのでる樹脂基板は使用できません。

オプション

- ・動作表示灯

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。